



ウェハ貼付装置装置

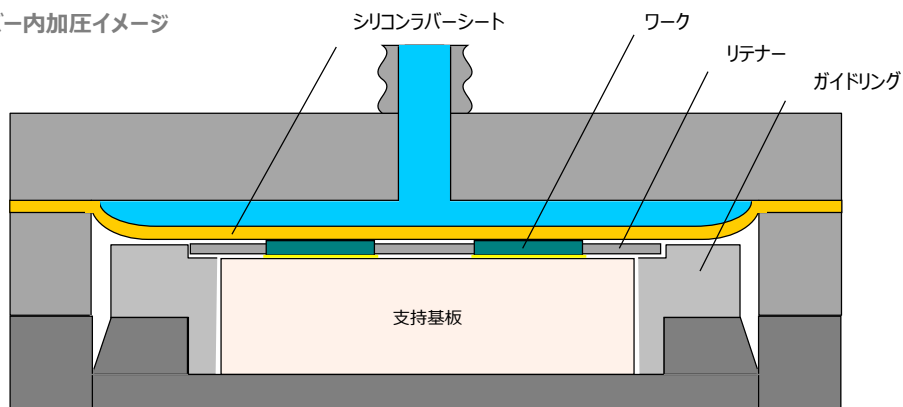
ウェハサイズ	3~6 inch
支持板	~φ190mm
重量	280kg
サイズ	W830×D800×H1582mm
設定温度範囲	室温~140℃
圧力設定範囲	0.05~0.3Mpa
入力電源	AC200V 1PH 50/60Hz
消費電力	35A
供給気体圧力	0.4~0.5MPa 700L/min(ANR) ※クリーンドライエアー
操作	マニュアル
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス

ケメットジャパン株式会社



研磨関連装置カタログ

チャンバー内加圧イメージ



ケメット・ジャパン株式会社
 千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
 TEL: 043-301-5408 <https://www.kemet.jp>

Kemet Japan Co.,LTD

Kemet Japan Co.,LTD

- ラッピング/ポリシング装置ラインナップ -



卓上型研磨装置

装置型式	LPM-15 (卓上型)	LPM-18 (卓上型)
定盤サイズ	φ380mm	φ457mm
対応ワークサイズ	~φ140mm	~φ180mm
重量	85kg	95kg
サイズ	W710 D 650 H 520mm	W820 D 730 H 620mm
操作	マニュアル	
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス	



据置型小型研磨機

装置型式	LPM-15 (据置型)	LPM-18 (据置型)
定盤サイズ	φ380mm	φ457mm
対応ワークサイズ	~φ140mm	~φ180mm
重量	320kg	400kg
サイズ	W 735 D 765 H1780mm	W 780 D 910 H1780mm
操作	マニュアル	
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス	



量産向据置型研磨機

装置型式	LPM-24 (オープン フェイス)	LPM-36 (オープン フェイス)	LPM-48 (オープン フェイス)
定盤サイズ	φ610mm	φ914mm	φ1219mm
対応ワークサイズ	~φ248mm	~φ368mm	~φ505mm
重量	1300kg	1500kg	3500kg
サイズ	W1415 D 1050 H 1550mm	W1730 D 1300 H 1600mm	W2040 D 1720 H 1600mm
操作	マニュアル		
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス		



加圧機構付据置型研磨機

装置型式	LPM-24 (加圧機構)	LPM-36 (加圧機構)	LPM-48 (加圧機構)
定盤サイズ	φ610mm	φ914mm	φ1219mm
対応ワークサイズ	~φ248mm	~φ368mm	~φ505mm
重量	1750kg	2100kg	4250kg
サイズ	W1415 D 1050 H 1800mm	W1730 D 1300 H 1955mm	W2040 D 1720 H 2240mm
操作	マニュアル		
対応アプリケーション	化合物、セラミクス、金属、ガラス		